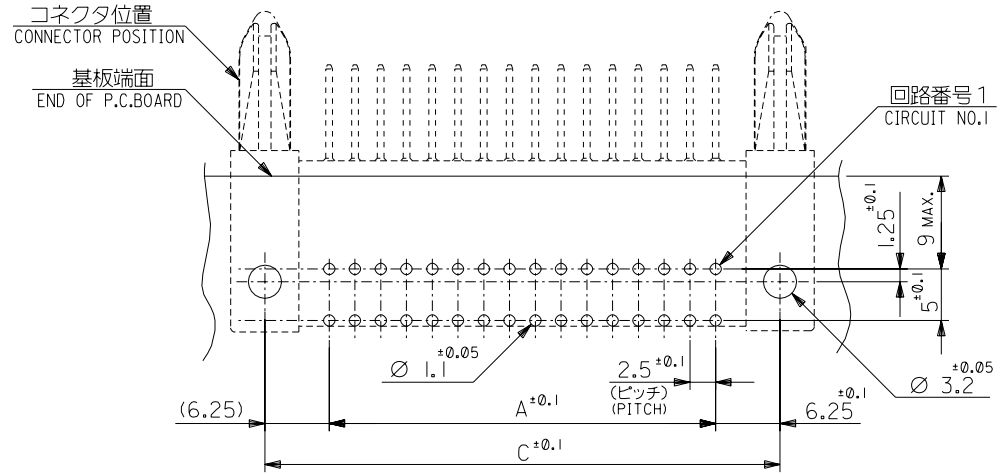
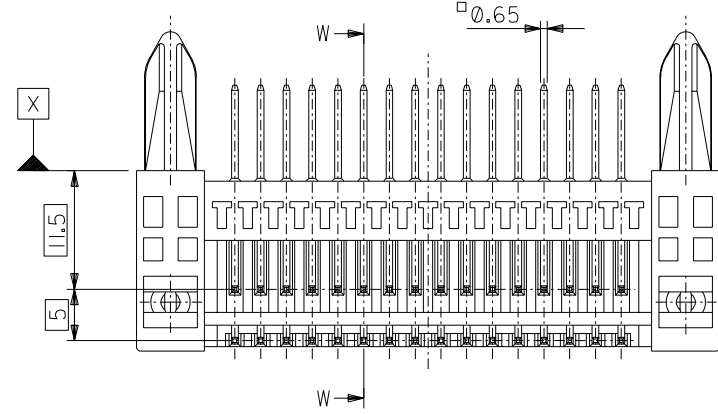
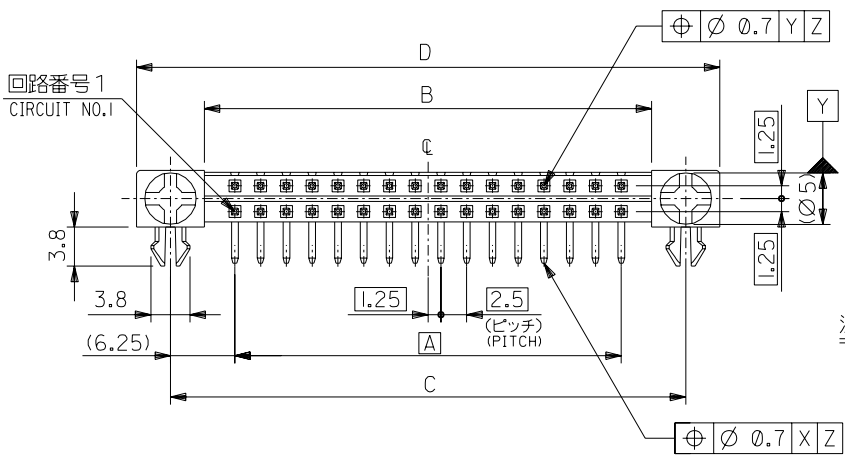
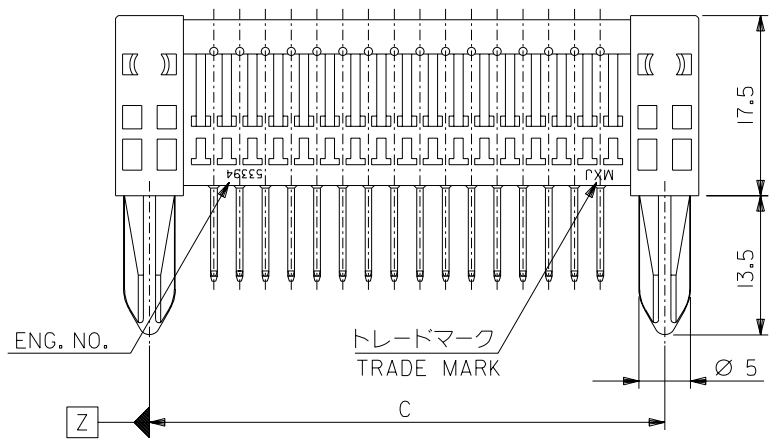
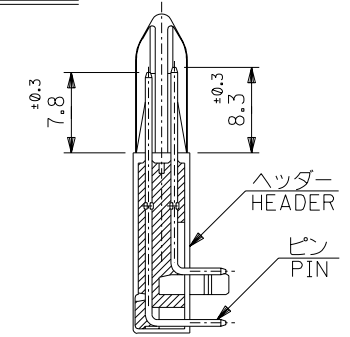
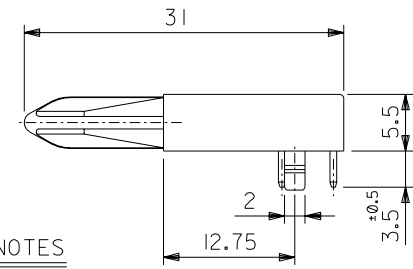


DWG. NO. SD-53394-001



基板取付穴推奨寸法 (部品実装面側)  
RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM. (MOUNTING SIDE)  
(基板厚: 1.6) (THK.: 1.6)



断面: W-W  
SECT. W-W

注記 NOTES

1. 嵌合相手: 52613-3229  
MATES WITH: 52613-3229
2. 材質 MATERIAL  
ヘッダー: 66ナイロン (ガラス入: 35%), UL 94V-0  
HEADER: 66NYLON(G.F.; 35%), UL94V-0  
ピン: 黄銅 (φ0.65), 銅下地 錫メッキ  
PIN: BRASS (φ0.65), TIN OVER COPPER PLATING
3. 本製品は53394-\*\*17の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53394-\*\*17.

56.6	50	43.4	37.5	53394-3219	32
D	C	B	A	MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKT.

MODEL NO. 53394-\*\*19

				材料 MATERIAL	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH	REVISIONS	
				適用電線範囲 WIRE RANGE	TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE	2.5 BOARD TO BOARD BOTTOM ENTRY CONN. HEADER ASS'Y-LEAD FREE	
				DRAWN BY '04/03/30 Y.WADA	CHK'D BY '04/03/30 M.SASAO	DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
				APP'D BY '04/03/30 M.SASAO	尺度 SCALE 2:1	SD-53394-001 0
角度 ANGLE	±3°					
30°以上 OVER	±0.3					
10°以上 OVER 30°未滿 UNDER	±0.25					
未滿 UNDER	±0.2					
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE		

DWG. NO.  
SD-53394-001

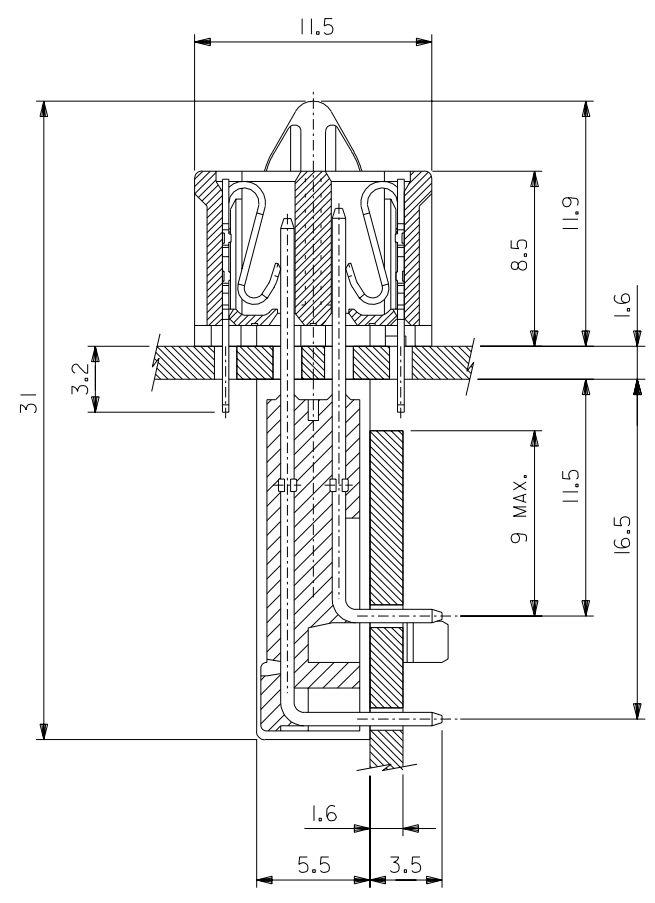
E

D

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A



嵌合状態図 (参考)  
MATING FIGURE (REF.)

角度 ANGLE	±3°						材料 MATERIAL	—H—
30 以上 OVER	±0.3						仕上げ FINISH	—H—
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25						適用電線範囲 WIRE RANGE	—H—
未満 UNDER 10 未満 UNDER	±0.2						被覆外径 INS. RANGE	—H—
一般公差 GENERAL TOLERANCES	①	RELEASED (J2004-3444) 新規作成	Y.W	M.S	04/03/30		DRAWN BY '04/03/30 Y.WADA	CHK'D BY '04/03/30 M.SASAO
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE			APP'D BY '04/03/30 M.SASAO	尺度 SCALE 4 : 1

MODEL NO.	53394-***19
MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 2.5 BOARD TO BOARD BOTTOM ENTRY CONN. HEADER ASS'Y-LEAD FREE	
DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)	REV ①
SD-53394-001	

SD-53394-001.502